

■ 2020年12月31日 星期四

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-052

华润微电子有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）核心技术人员何波浦先生于近日因个人职业发展原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，何波浦先生将不在公司担任任何职务。

● 何波浦先生辞职后，其负责的工作由方浩先生负责，何波浦先生的离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、何波浦先生离职的具体情况

公司核心技术人员何波浦先生于近日因个人职业发展原因申请辞去相关职务并办理完成相关离职手续。

何波浦先生于2009年8月加入公司，2000年至2003年期间任IBM研究科学家；于2003年至2004年期间任中芯国际资深经理；于2005年至2006年期间任新加坡特许半导体制造有限公司资深经理；于2008年至2009年期间任上海交通大学副研究员；于2009年至2020年1月期间历任无锡华润华联技术有限公司技术研发部副处长、技术研发中心研发总监、研发高级总监、无锡华润华联科技有限公司总经理助理；于2020年2月至2020年12月任华润微电子有限公司技术研发部经理兼技术管理总监。

根据何波浦先生的劳动合同及保密及工作成果归属协议相关条款，何波浦先生同意就公司及其披露的关于公司的任何保密信息尽职尽责的保密，并同意在征得公司事书面同意前，不再向或透露以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至目前，何波浦先生已完成与方浩先生的工作交接，公司核心技术人员及研发团队仍将继续对公司产品及技术创新的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司关于何波浦先生的劳动合同和保密及工作成果归属协议，审阅其中相关条款及承诺书；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就何波浦先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司与何波浦先生离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发部门核心技术人员总体相对稳定。何波浦先生已与公司就相关工作的交接，其负责的工作由方浩先生负责，何波浦先生的离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司核心技术。

2、何波浦先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议，何波浦先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展及技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司核心技术研发和日常经营均正常进行，何波浦先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

核心技术人员姓名

年度	核心技术人员姓名
2017年度	李虹、陈南湖、马伟清、余金荣、王平、苏巍、吴忠志、何波浦、丁东民、罗先才、方浩、计建峰、刘小军、胡良兵、张洪、张勇、夏长勇
2018年度	李虹、陈南湖、马伟清、余金荣、王平、苏巍、吴忠志、何波浦、丁东民、罗先才、方浩、计建峰、刘小军、胡良兵、张洪、张勇、夏长勇、唐铁生
2019年度	李虹、陈南湖、马伟清、余金荣、王平、苏巍、吴忠志、何波浦、丁东民、罗先才、方浩、计建峰、刘小军、胡良兵、张洪、张勇、夏长勇

截至本公告披露日

李虹、马伟清、余金荣、王平、苏巍、吴忠志、何波浦、丁东民、罗先才、方浩、计建峰、刘小军、胡良兵、张洪、张勇、夏长勇

本公司对技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因何波浦先生的离职产生重大不利变动，何波浦先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

任职期间，何波浦先生主要负责公司科技管理部日常工作，何波浦先生离职后其负责的工作由方浩先生负责，方浩先生负责，何波浦先生的离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、何波浦先生离职的具体情况

公司核心技术人员何波浦先生于近日因个人职业发展原因申请辞去相关职务并办理完成相关离职手续。

何波浦先生于2009年8月加入公司，2000年至2003年期间任IBM研究科学家；于2003年至2004年期间任中芯国际资深经理；于2005年至2006年期间任新加坡特许半导体制造有限公司资深经理；于2008年至2009年期间任上海交通大学副研究员；于2009年至2020年1月期间历任无锡华润华联技术有限公司技术研发部副处长、技术研发中心研发总监、研发高级总监、无锡华润华联科技有限公司总经理助理；于2020年2月至2020年12月任华润微电子有限公司技术研发部经理兼技术管理总监。

根据何波浦先生的劳动合同及保密及工作成果归属协议相关条款，何波浦先生同意就公司及其披露的关于公司的任何保密信息尽职尽责的保密，并同意在征得公司事书面同意前，不再向或透露以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至目前，何波浦先生已完成与方浩先生的工作交接，公司核心技术人员及研发团队仍将继续对公司产品及技术创新的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司关于何波浦先生的劳动合同和保密及工作成果归属协议，审阅其中相关条款及承诺书；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就何波浦先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司与何波浦先生离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发部门核心技术人员总体相对稳定。何波浦先生已与公司就相关工作的交接，其负责的工作由方浩先生负责，何波浦先生的离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司核心技术。

2、何波浦先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议，何波浦先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展及技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司核心技术研发和日常经营均正常进行，何波浦先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020年12月31日

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2020-052

地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次赎回理财产品名称：平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品

● 本次赎回理财产品金额：50,000,000元

● 本次理财产品名称：平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品

● 本次理财产品期限：90天

● 本次理财产品起息日：2020年12月29日

● 本次理财产品到期日：2021年3月30日

● 提前终止权：投资者无权提前终止

● 预期年化收益率：1.65%-3.35%，根据该产品挂钩的标的定价确定，测算收益不等于实际收益。

● 本金保障：保本

● 产品类型：50,000,000元

（三）委托理财的金额及投向

公司于2020年12月29日与平安银行股份有限公司上海长风支行（以下简称“平安银行”）签订了协议，以46,000,000万元闲置募集资金购买了91天的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品，该产品起息日期为2020年9月29日，产品到期日为2020年12月29日，预期年化收益率为1.65%-4.65%，根据该产品挂钩标的定价确定。具体内容详见公司于2020年9月30日在《上海证券报》及《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

截至目前，公司尚未赎回该理财产品，公司未发现何波浦先生离职后对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

任职期间，何波浦先生主要负责公司科技管理部日常工作，何波浦先生离职后其负责的工作由方浩先生负责，方浩先生负责，何波浦先生的离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、何波浦先生离职的具体情况

公司核心技术人员何波浦先生于近日因个人职业发展原因申请辞去相关职务并办理完成相关离职手续。

何波浦先生于2009年8月加入公司，2000年至2003年期间任IBM研究科学家；于2003年至2004年期间任中芯国际资深经理；于2005年至2006年期间任新加坡特许半导体制造有限公司资深经理；于2008年至2009年期间任上海交通大学副研究员；于2009年至2020年1月期间历任无锡华润华联技术有限公司技术研发部副处长、技术研发中心研发总监、研发高级总监、无锡华润华联科技有限公司总经理助理；于2020年2月至2020年12月任华润微电子有限公司技术研发部经理兼技术管理总监。

根据何波浦先生的劳动合同及保密及工作成果归属协议相关条款，何波浦先生同意就公司及其披露的关于公司的任何保密信息尽职尽责的保密，并同意在征得公司事书面同意前，不再向或透露以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至目前，何波浦先生已完成与方浩先生的工作交接，公司核心技术人员及研发团队仍将继续对公司产品及技术创新的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司关于何波浦先生的劳动合同和保密及工作成果归属协议，审阅其中相关条款及承诺书；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就何波浦先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司与何波浦先生离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发部门核心技术人员总体相对稳定。何波浦先生已与公司就相关工作的交接，其负责的工作由方浩先生负责，何波浦先生的离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司核心技术。

2、何波浦先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议，何波浦先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展及技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司核心技术研发和日常经营均正常进行，何波浦先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020年12月31日

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为18人、21人、20人及17人，人员稳定，具体人员如下：

2017年、2018年、2019年及截至本公告披露日，公司研发人员数为623人、643人、653人及710人，占员工总人数比例分别为7.79%、8.08%、8.80%、8.80%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量